財團法人金屬工業研究發展中心
醫材產業服務組

2017 印度國際醫療展

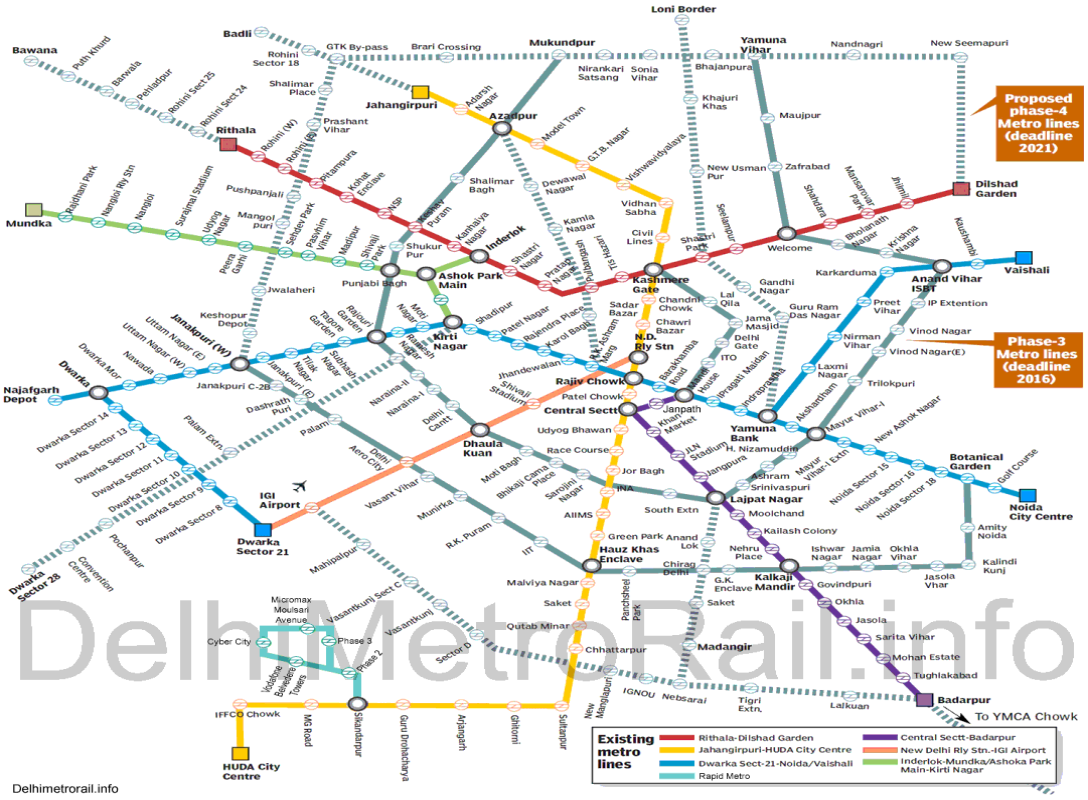
MEDICAL FAIR INDIA 2017

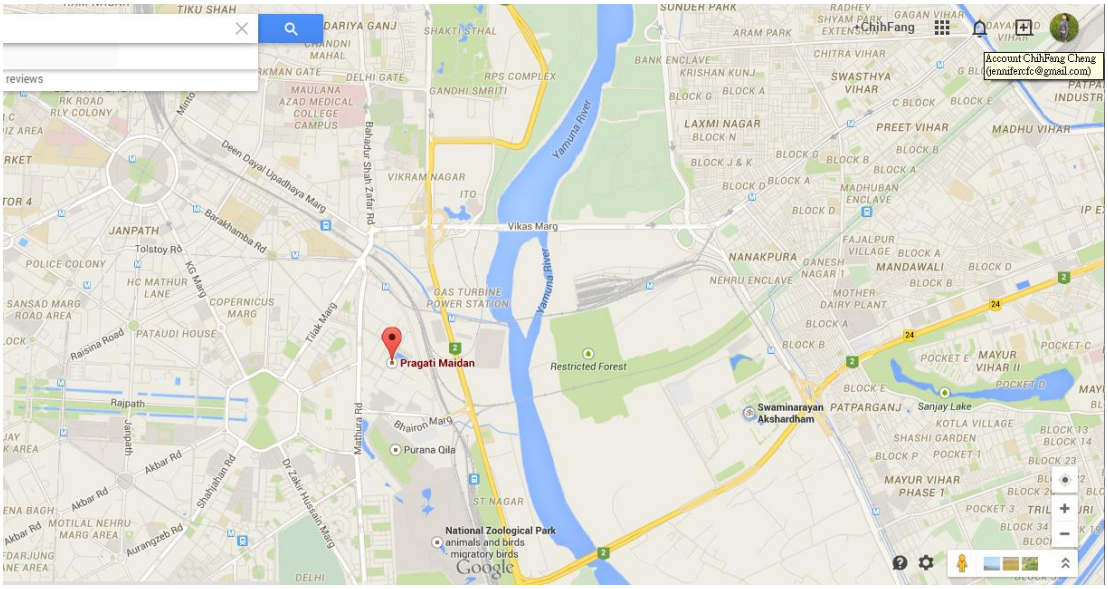
一、組團說明：

(一)承辦單位：財團法人金屬工業研究發展中心

(二)活動簡介：**http://www.medicalfair-india.com/**

- 名稱：「第**23**屆印度國際醫療展 (Medical Fair INDIA 2017)」
- 官方網站連結：**http://www.medicalfair-india.com/**
- 展覽日期：**2017**年**04**月**06-08**日
- 展覽地點：**Pragati Maidan, New Delhi, India**





展會簡介：

2015 年已超過 500家廠商展出，並將突破 16,000人以上醫療器械行業專業買主參加 Medical Fair India 是南亞及中亞地區醫療領域最著名的展覽會之一，每年於新德里及孟買兩大城市交替展出。近年來，印度醫療產業發展迅速，同時該地區對醫院、醫療設備的需求量也不斷增大，MEDICAL FAIR INDIA 已成為印度醫療領域裏的盛會。2015年展會規模又創新高，除了展出內容包含所有醫療相關設備與領域外，參展廠商之素質更為其他醫療展所望塵莫及。2015年有來自台灣、德國、美國、馬來西亞、韓國、中國、印度、哈薩克、巴基斯坦…等21個國家的參展商盛情參與，對參展成效也十分滿意！

2015年展覽數據:

參展廠商: 共512家，分別來自21個國家

參觀買主: 共10,700人

(三)印度市場：

醫療保健業以15.1%年複合成長率持續六年增長，預計2017年將可達1600億美元。2014年印度衛生醫療預算增長27%，2015年預算將達57億美元。印度總人口數約12億1千萬人，由於經濟快速成長及中產階級人口比例不斷攀升，成長空間大，對於醫療器材的需求也不斷增加。印度目前一年的醫療器材市場需求約30億美元。過去6年來印度的醫療器材需求每年約增加12~16 %，印度醫療器材需求主要有75 %來自進口，對各國廠商來說，是一個兵家並爭的市場。在印度經濟改革開放下，其市場經濟有大幅的成長，未來10 年內人民消費力將成長3.5 倍。根據麥肯錫全球研究院的報告，預測到了2015 年，印度的中產階級以上人口將來到21%，即2億5410萬人；到了2025年，將創造出5.8億的中產階級。大量的中產階級出現，使此族群消費並要求更高品質的醫療照護服務，各醫材大廠也看準印度市場的發展而紛紛投入。根據Espicom 的預估，印度醫材市場2011~2016年的年複合成長

率為13.7%，為全球成長最快的市場之一。經濟合作暨發展組織（OECD）2013年發布OECD經濟展望報告指出，印度可望超越日本，成為全球第三大經濟體。另自2020年開始，印度經濟成長率更可能超越中國大陸。報告中預估2014年全球GDP 年成長率分別為4%，印度2013年GDP 成長率則為5.3%，潛力驚人。

(四)廠商補助名額：評選8家正取廠商，1家備取廠商，本中心保留審核權利。
每家公司攤位面積 9m² (3m＊3m)、展證(2015年每四平方米一張展証，實際數量以2017年大會公佈為準)

二、參加廠商資格：

須為我國政府立案之醫療器材製造商，最近一年有出口實績者，產品需為台灣製造。

有下列情形之一者，不符申請資格：

(一)屬銀行拒絕往來戶，且企業淨值(股東權益)為負值。

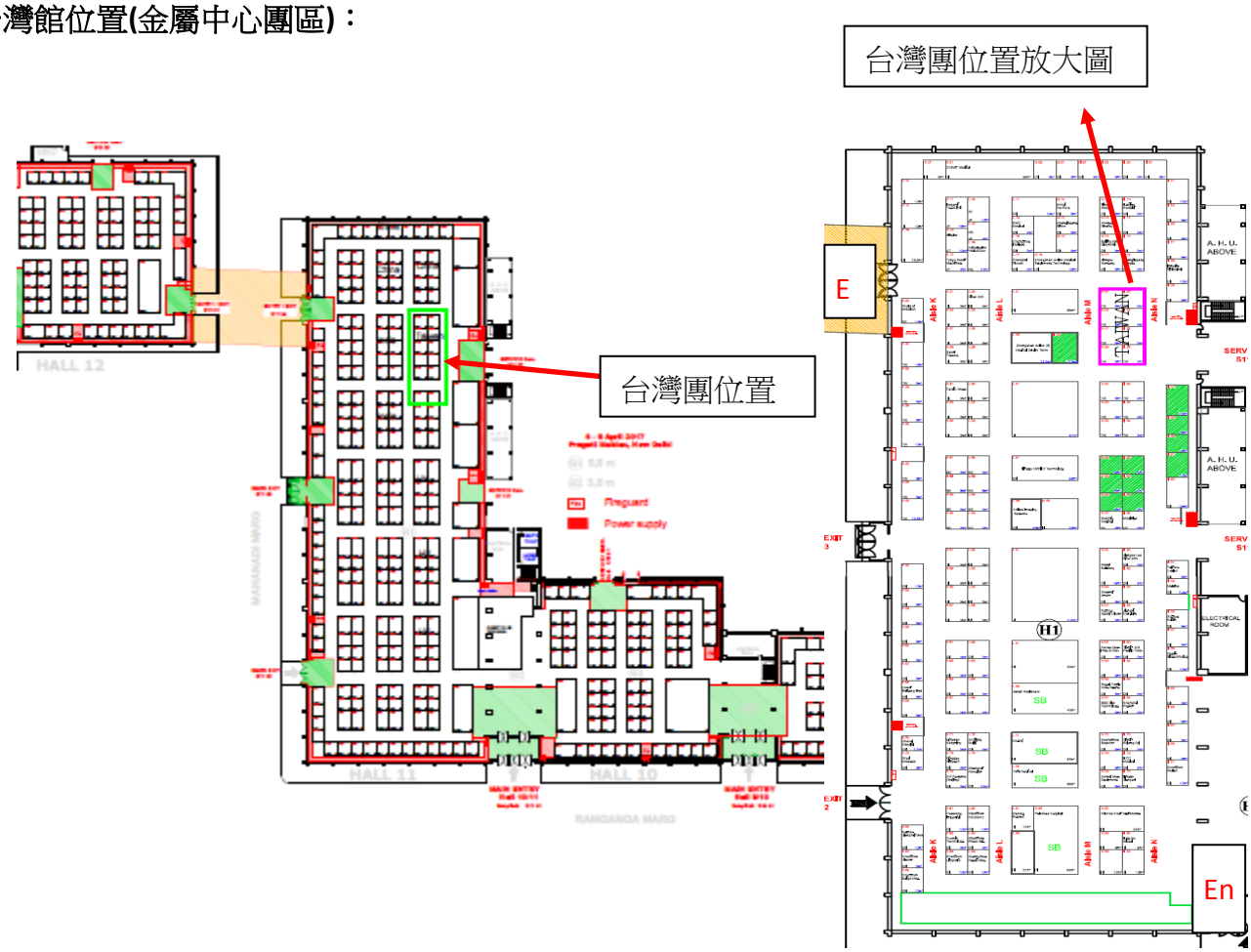
(二)最近5年內曾有執行政府補助計畫之重大違約紀錄。

(三)有因執行政府補助計畫受停權處分且其期間尚未屆滿情事。

(四)申請企業至收件截止日前有欠繳應納稅捐情事。

(五)至本計畫公告收件截止日前1年內，有受註銷、撤銷或暫停出進口處分紀錄者。

三、台灣館位置(金屬中心團區)：



展出方式：

1. 以「台灣醫療器材產業聯盟」為展出主軸，整合產品線集體國際行銷。
2. 入選本次補助台灣團區廠商一律採用「開放式裝潢設計」，靈活使用攤位空間，塑造整體行銷聯盟形象。
3. 入選本次補助台灣團區廠商於 106 年年底本計畫結案時，須配合提供該(106)年度外銷出口實績 40 萬美金以上訂單。
4. 攤位規劃示意圖　　全區攤位均無隔間

A	A
B	B
B	B
A	A

入選廠商負擔部分費用：

- A 區廠商預繳 NTD. 14 萬元，B 區廠商預繳 NTD. 13 萬元，展後退還 NTD. 6 萬元保證金。
- 費用 (攤位+開放式裝潢，含稅)

類　　型	攤 位 代 號	實收費用(NTD)/萬
雙面開攤位	A 區	8
單面開攤位	B 區	7

攤位+開放式裝潢含：
台灣館整體形象裝潢設計
（每攤位基本配備為公司招牌、地毯、桌椅、投射燈、插座、展櫃等等，依設計圖配置為主）

裝潢外觀示意圖

(僅供參考，實際裝潢設計圖成團後發包，實際提案圖稿將發送入選廠商)

四、**本展將就徵集參展廠商做資格篩選，篩選標準如下：**

需請廠商出席簡報審查會議，由報名廠商自行簡報公司簡介供審查委員審查。

1.需台灣製造商 (請提供-工廠登記證、GMP)

2.**產品具出口競爭力 (入選廠商於年底結案時需提供 106 年度 40 萬美金以上外銷出口訂單-INOVICE 等證明)**

3.產品認證 (請提供-CE、FDA、ISO13485 等證書影本)

4.公司/產品獲獎實績 (請提供-證書影本、獎盃/獎牌照片)參考條件

5.創新研發 (請提供-參與政府 研發補助計畫 or 專利證明)參考條件

五、**付款方式：**

1.「頭款-保證金」:

廠商需於公佈入選後，兩個星期內繳交 6 萬元參展保證費用，超過繳費期限將由備取廠商依序遞補之；此保證金為保障入選廠商受補助之權利。

2.「尾款-參展費用」:

組團說明會議後，完成繳交參展費用餘額，A 區 8 萬，B 區 7 萬。

繳交完參展保證金或參展費用後，廠商因個別因素退出參展團時，恕不退還已繳交之保證金或參展費用，參展名額將由備取廠商遞補之。

六、**廠商注意事項：**

1.標示 Made in China 之產品不得參加

2.請入選廠商於組團會議務必派員出席，避免權益受損

3.廠商入選後因個別因素而非本中心或天然災害，退出時應以書面或 e-mail 正式通知本中心
4.廠商展品若於海關或參展期間被扣留、沒收、遺失，亦不退費
5.參加廠商不得與其他非本團團員共用其攤位，亦不得擅自轉讓攤位
6.為維護整體形象，除原配置海報位置外，廠商如須於攤位內張貼宣傳品，請知會本中心
7.展覽活動期間內必須在場看顧樣品接洽交易，並協助提供資料以便本中心分析市場及統計推銷成果，其涉及業務機密部分，本中心將予審慎保密
8.參加廠商之展品、出版品刊登產品圖文，不得涉及商品仿冒或侵害國內外其他廠商之專利權、商標權及智慧財產權，如涉及仿冒事宜，由廠商自行負擔所有責任，並支付衍生之訴訟仲裁等費用，以及活動主辦國行政或司法裁定之賠償或罰鍰
9.攤位位置順序於組團會議中依抽籤決定

七、參團廠商自行負擔費用部份：

1.展品包裝報關、出口裝櫃、船運、保險、及在目的地國之通關提貨、內陸運輸及進場、關稅費用及相關手續費用
2.超出本中心裝潢所提供之攤位配備費用
3.參加廠商代表之食宿、機票、交通、簽證費及行李超重等費用
4.活動結束後樣品處理費用
5.其他臨時發生，無法以本中心預算容納之費用

八、報名期限：

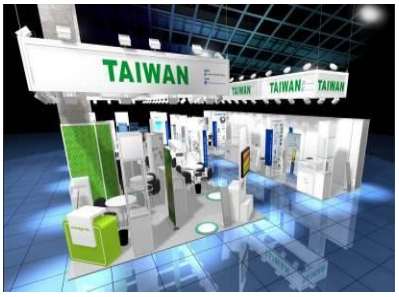
即日起至 **2017 年 01 月 13 日(五)止**
審查會日期:暫定為 **2015 年 01 月 17 日(二)**
實際審查日期以正式審查會通知為準

九、報名聯絡方式

聯 絡 人：鄭至芳　　聯絡信箱：**jennifer@mail.mirdc.org.tw**
聯繫電話：**07-6955298 (分機 259)**　　傳真號碼：**07-6955627**

十、金屬中心歷屆展會實務

2009 德國科隆牙科展覽	2010 美國芝加哥牙科展覽

2011 德國科隆牙科展覽	2012 巴西聖保羅醫療展覽	2013 德國科隆牙科展覽
		

財團法人金屬工業研究發展中心
醫材產業服務組

第 23 屆印度國際醫療展 (Medical Fair India2017)
廠商報名資料

廠商名稱	（中文）					
	（英文）					
企業基本資料	負責人姓名		職稱		統一編號	
	聯絡人姓名		職稱		E-mail	
	電話			傳真		
	地址					
	員工人數	人		登記資本額	元	
	GMP設廠	☐有(請檢附證明) ☐無		公司登記	年 月	
	產品名稱(中/英)					

報名攤位 ☐A區 雙面開攤位 (廠商預繳NTD.14萬元，展後退NTD.6萬元)
☐B區 單面開攤位 (廠商預繳NTD.13萬元，展後退NTD.6萬元)

一、創新研發實績 (參與政府研發補助計畫or專利申請)
☐ 是 (請檢附/計畫書封面影本or專利證書影本) ☐ 否

二、出口貿易實績
☐ 是 (展後請檢附/INOVICE影本) ☐ 否

三、產品認證 (CE、FDA、ISO13485)
☐ 是 ☐ 否

四、公司/產品獲獎實績
☐ 是 (請檢附/證書影本or獎盃/獎牌照片) ☐ 否

報名廠商 公司簽章	敝司已詳閱本徵展通知並同意配合上述參加條件與規定

欲參加本展覽之廠商，請填寫完報名表後於 2017 年 1 月 13 日（星期五）前傳真 07-6955627 或 mail (jennifer@mail.mirdc.org.tw)予我們，以利後續作業 。謝謝您！

財團法人金屬工業研究發展中心
個人資料蒐集、處理、利用告知暨同意書

本中心因受　工業局　　委託執行/辦理　醫療器材產業技術輔導與推廣計畫 之事由，蒐集、處理及利用您所提供，或未來將提供的個人資料，茲依據個人資料保護法（以下稱個資法）第 8 條規定告知下列事項：
(一)蒐集目的：辦理本次活動及相關行政管理。
(二)個資類別：辨識個人者如姓名、職稱、聯絡方式、地址等。
現行之受僱情形如公司名稱、部門、職稱等。
(三)利用期間：至蒐集目的消失為止。
(四)利用地區：除蒐集之目的涉及國際業務或活動外，本中心僅於中華民國領域內利用您的個人資料。
(五)利用對象及方式：於蒐集目的之必要範圍內，利用您的個人資料。
(六)當事人權利：您可向本中心行使查詢或請求閱覽、製給複製本、補充或更正、停止蒐集處理利用或刪除您的個人資料之權利。
(七)不同意之權益影響：若您不同意提供個人資料，本中心將無法為您提供特定目的之相關服務。

辦理本次活動外其他蒐集目的告知：
蒐集目的：參展意願證明與聯絡窗口。
本人已閱讀並了解上述之告知事項，並同意　貴中心在符合上述告知事項範圍內蒐集、處理及利用本人個人資料。

簽名

日　　期：　　年　　月　　日